

3月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

洞察行情 精准决策

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情、市场重点趋势等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子订阅号，及时获取报告发布等信息。您可以通过联系安芯易客户经理或通过 marketing@360ic.com 获取完整版报告。

目录

摘要	1
一、宏观动态	2
(一) 经济景气跟踪	2
(二) 行业需求动态	3
(三) 资本市场动态	4
(四) 产业政策动态	5
二、半导体产业动态	6
(一) 短期影响	6
(二) 中期影响	7
(三) 长期影响	8
三、终端市场动态	9
(一) 人工智能	9
(二) 新能源	10
(三) 汽车	11
四、重点产品行情	13
(一) 服务器 GPU: 受益于大型云端服务厂商订单拉动, AI 服务器 GPU 出货有望高增	13
(二) 存储芯片: 现货市场成交压力较大, Q2 预计 DRAM 环比涨幅较小	13
(三) MCU: 整体库存 Q2 有望回至健康水位, 部分车规类器件货期较长	14
(四) 模拟芯片: Q1 末库存有望见底, Q2 交期或将延长	15
五、市场重点趋势	15
信息来源	17
免责声明	19

摘要

2024 年 3 月重点行情趋势	
宏观趋势	▪ 全球经济有望修复，中国制造业景气回暖，新出口订单指数上升至 51.3 ▪ 全球芯片市场复苏显著，中国地区增长表现较好，销售额同比高增 28.8%
产业动态	▪ 三星对其 NAND 闪存目标涨价 15%-20%，看好存储芯片价格持续回升 ▪ 半导体龙头厂商加码投资印度市场，看好印度芯片需求增长
终端市场	▪ 人工智能：Kimi 大模型发布，预计 AI 算力需求进一步提升 ▪ 新能源：国内储能龙头厂商加速出海进程，看好美国、日本等市场增长 ▪ 汽车：小米汽车 SU7 正式发布，锁单量达 4 万辆，AI 将推动汽车智能化趋势加深
产品行情	▪ 服务器 GPU：云端服务厂商需求旺盛，AI 服务器 GPU 出货有望高位增长 ▪ 存储芯片：终端需求继续承压，DRAM 环比涨幅预计放缓 ▪ MCU：整体库存 Q2 有望回至健康水位，市场价格或将上调 ▪ 模拟芯片：Q1 末库存有望见底，Q2 交期或将延长

一、宏观动态

(一) 经济景气跟踪

● 全球经济有望修复，中国制造业景气回暖，新出口订单上升

24 年 3 月，根据 JP Morgan 数据，全球制造业 PMI 为 50.6，已在今年起进入扩张区间。JP Morgan 认为，全球制造业在 2024 年或将迎来修复，有望提振我国出口。

分区域来看：

亚洲方面，中国地区制造业 PMI 回升至 50.8，为 23 年 9 月以来首次回到荣枯线以上，主要系新出口订单（51.3）所带动，环比上升 5.0pct。根据国家统计局数据，汽车、计算机通信电子设备等行业新出口订单指数高于临界点，相关行业外贸业务较上月增加，产需释放较快。高技术制造业 PMI 为 53.9，高端制造业延续增长态势。印度制造业 PMI 高达 59.1，主要系产出和新订单双双加速增长。日本制造业 PMI 延续疲弱态势；韩国、越南制造业 PMI 跌破荣枯线，主要系生产和新订单均略有下滑。其中，尽管韩国出口需求增长较快，但其内需疲软抵消了海外需求增长，整体制造业表现较弱。

美洲方面，美国 ISM 制造业 PMI 达 50.3，是 2022 年 10 月以来首次回升扩张区间。墨西哥制造业 PMI 达到 52.2，与上月的 52.3 基本持平，制造业增长稳健。

欧洲方面，欧元区制造业 PMI 继续下滑，仍处于收缩区间。

全球各地区制造业 PMI

时间	全球	中国	日本	韩国	印度	越南	美国	墨西哥	欧元区
2023-03	49.60	51.90	49.20	47.60	56.40	47.70	46.30	51.00	47.30
2023-04	49.60	49.20	49.50	48.10	57.20	46.70	47.10	51.00	45.80
2023-05	49.60	48.80	50.60	48.40	58.70	45.30	46.90	50.50	44.80
2023-06	48.80	49.00	49.80	47.80	57.80	46.20	46.00	50.90	43.40
2023-07	48.70	49.30	49.60	49.40	57.70	48.70	46.40	53.20	42.70
2023-08	49.00	49.70	49.60	48.90	58.60	50.50	47.60	51.20	43.50
2023-09	49.10	50.20	48.50	49.90	57.50	49.70	49.00	49.80	43.40
2023-10	48.80	49.50	48.70	49.80	55.50	49.60	46.70	52.10	43.10
2023-11	49.30	49.40	48.30	50.00	56.00	47.30	46.70	52.50	44.20
2023-12	49.00	49.00	47.90	49.90	54.90	48.90	47.40	52.00	44.40
2024-01	50.00	49.20	48.00	51.20	56.50	50.30	49.10	50.20	46.60
2024-02	50.30	49.10	47.20	50.70	56.90	50.40	47.80	52.30	46.50
2024-03	50.60	50.80	48.20	49.80	59.10	49.90	50.30	52.20	46.10

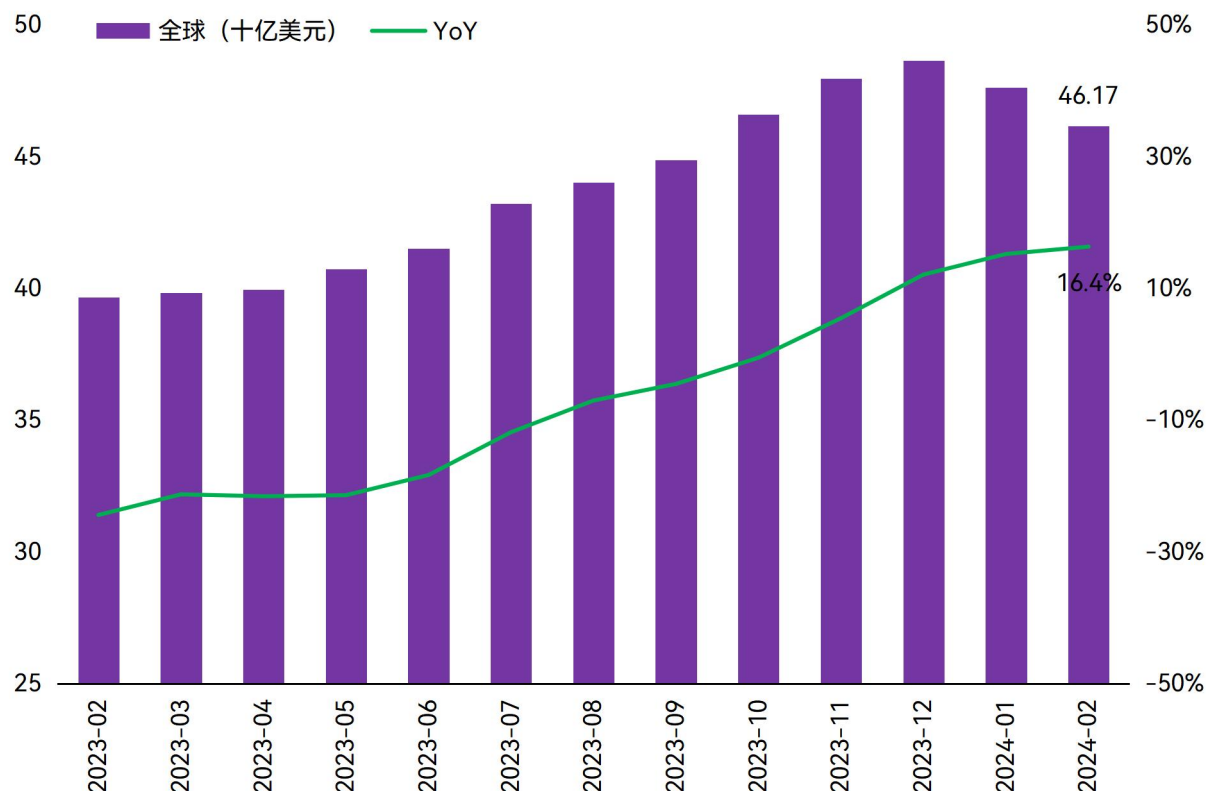
数据来源：Choice

(二) 行业需求动态

● 全球半导体市场需求复苏明确，中国地区增长表现较好

24 年 2 月，全球半导体销售额继续呈现环比下滑趋势（-3.1%），但同比增长表现较好，达 16.4%。从 24 年 1-2 月来看，全球半导体销售额累计达 938 亿美元，累计同增 15.8%，复苏态势显著。

全球半导体销售额（十亿美元）



数据来源：SIA

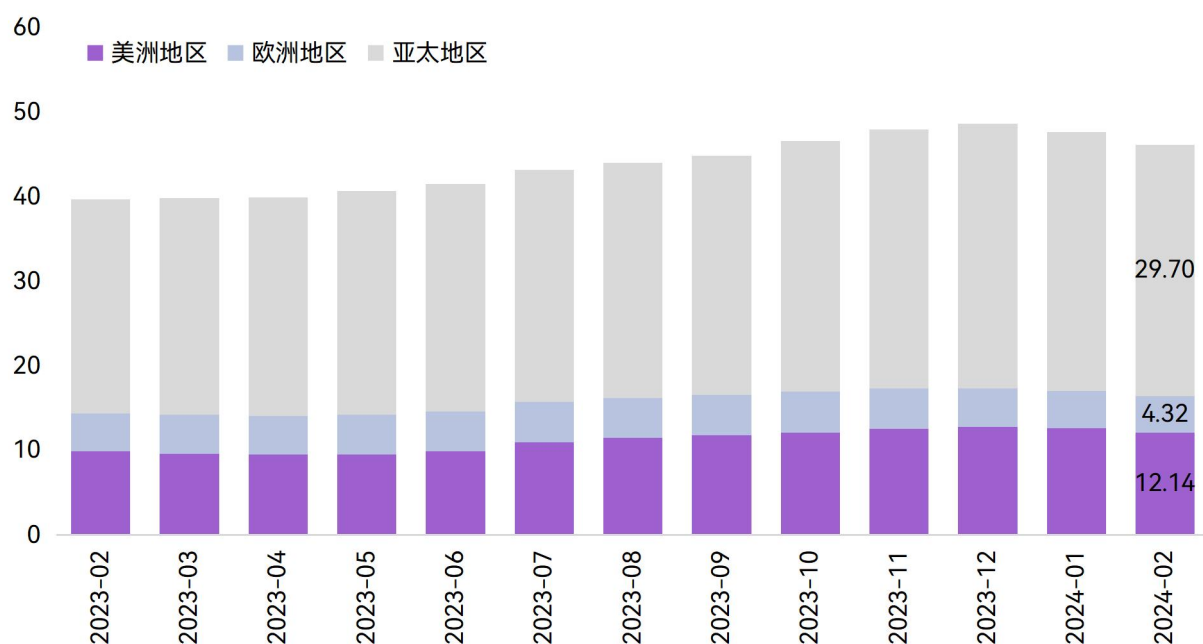
分区域来看：

亚太地区，2 月销售额达 297 亿美元（同比+17.6%），市场份额 64.3%；1-2 月累计销售额为 602.8 亿美元（累计同比+16.80%）。其中，中国地区销售额达 141.3 亿美元，同比大增 28.8%，占据全球市场份额达 30.60%。日本地区需求延续下滑趋势，环比及同比双双下滑（-2.7%/-8.5%）。

美洲地区，市场需求持续复苏、增速较快（同比+22.0%），主要系墨西哥制造业景气度较高，各大车企陆续在墨西哥布局产能。

欧洲地区，市场需求相对疲软，销售额同比降幅扩大（-3.4%），整体经济仍处于衰退边缘。

分地区半导体销售额（十亿美元）



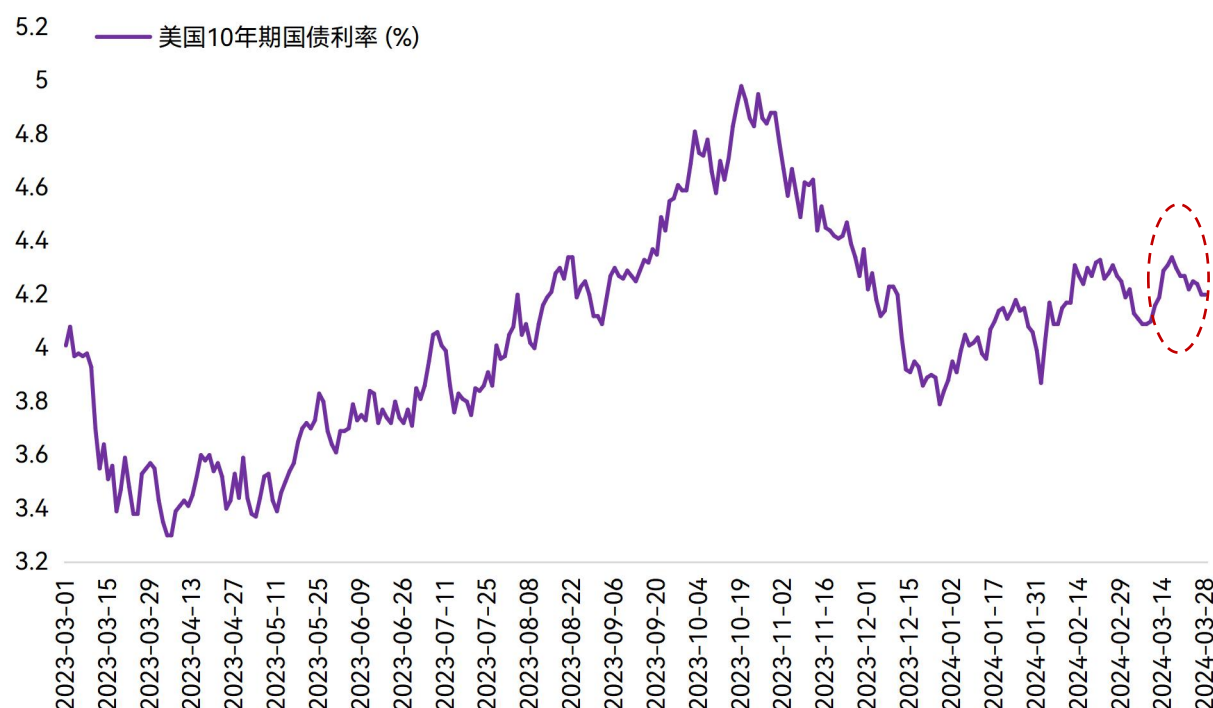
数据来源：SIA

（三）资本市场动态

● 美国 10 年期国债利率维持相对高位，关注进出口贸易汇率风险

24 年 3 月，美国 10 年期国债利率仍然维持相对高位，由于美国 3 月就业数据表现超预期，预计美联储降息时点将会后置，持续关注进出口贸易汇率风险。

美国 10 年期国债利率(%)

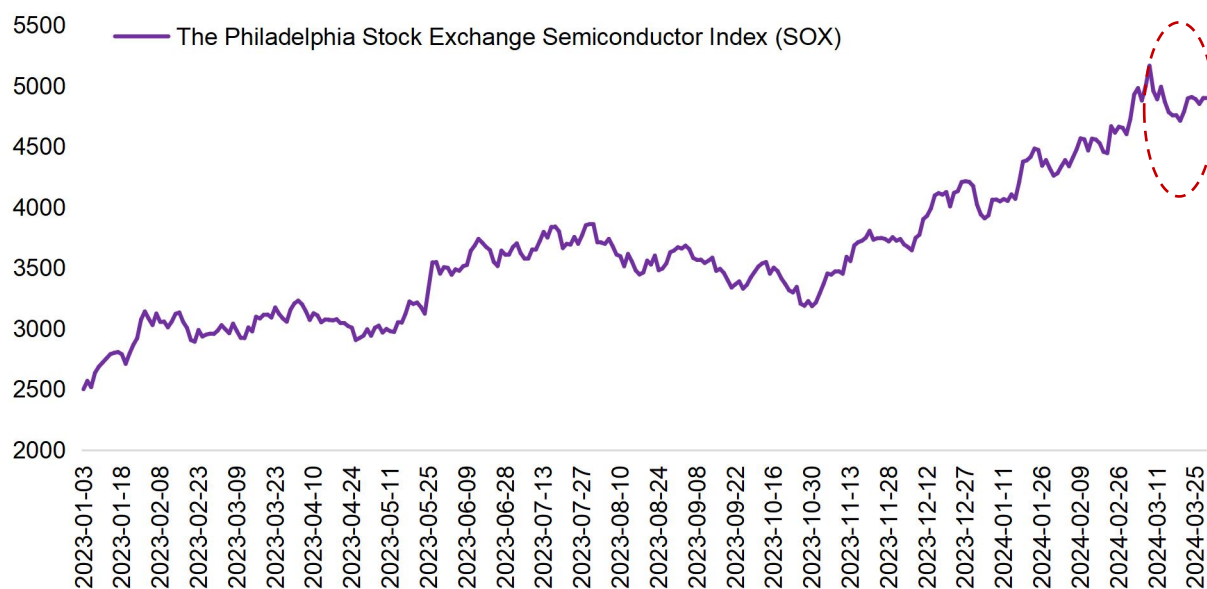


数据来源：Choice

● 费城半导体指数小幅回调，主要系市场过热而降温影响

费城半导体指数（SOX）3月有所下滑，主要系近期市场过热、有所降温所致。从长期来看，人工智能的火热预计仍将带动科技股股价稳健成长。

费城半导体指数（SOX）



数据来源：Choice

（四）产业政策动态

● 美国修改对华芯片限制政策，扩大至 PC 领域

3月29日，美国拜登政府修改了对华芯片限制规则，其中限制规则也将适用于包含 AI 芯片的笔记本电脑，这意味着美国芯片对华限制扩大到更广泛的消费电子领域。

● 美国将联手墨西哥合作探索半导体供应链新机会

美国国务院表示，随着拜登政府正推动减少对中国内地及中国台湾的技术依赖，美国将与墨西哥合作，探索半导体供应链的新机会。合作伙伴关系将从评估墨西哥现有的半导体行业、监管框架和劳动力需求开始。

● 韩国大力发展 AI 产业，加快推动 HBM 及 AI 芯片出口

韩国产业通商资源部长官安德根表示，韩国政府将积极支持半导体产业，加快开发 HBM 和 AI 芯片，以实现每年 1200 亿美元的出口目标。SK 海力士目前正寻求到 2046 年在韩国地区建造四座制造工厂，预算为 120 万亿韩元。

● 印度削减电动汽车进口关税，有望加速发展电动汽车产业

印度政府同意削减在印建厂的跨国公司电动汽车进口关税。根据印度商业和工业部声明，只要企业承诺在 3 年内投资至少 415 亿卢比（约 5 亿美元），并在本地工厂生产电动车，即可

获得税收优惠。据悉，价格在 3.5 万美元以上的电动汽车将在 5 年内享受 15%的进口减税。同时，承诺投资超过 8 亿美元的公司电动汽车总进口额度将达 4 万辆，每年 8000 辆。

● 欧盟计划对从中国进口的电动汽车进行海关登记，或将征收追溯性关税

欧盟委员会发布通知称，计划开始对从中国进口的纯电动汽车进行海关登记。据路透社报道，此举为欧盟对中国电动汽车发起“反补贴调查”的一部分，若最终调查认定中国电车接受了所谓“不公平补贴”，欧盟有可能将对这些登记在册的进口车辆征收“追溯性关税”。

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
短期影响	高塔半导体	计划将其美国纽波特海滩市的大部分业务关闭三周	行业还未整体回暖
	Arm	首次面向汽车应用发布高性能芯片设计	智能汽车有望加速量产
	三星	计划在 3 月至 4 月期间，与大客户重新协商 NAND 闪存价格，目标涨价 15%至 20%	NAND 内存有望涨价
中期影响	台积电	3nm 制程获苹果、英特尔及 AMD 频频追单	看好先进制程增长
	日月光	获苹果先进封装订单，预计下半年开始生产	先进封装产能供不应求
	SK 海力士	预计今年 HBM 芯片占公司 DRAM 芯片销售比重达两位数	看好 HBM 需求增长
	三星	将推出采用 LPDDR 内存的 AI 芯片	AI 芯片竞争加剧
长期影响	高通	计划在印度建设设计中心	看好印度市场增长
	瑞萨电子	将在印度合资建设封测厂	看好印度市场增长
	格芯	针对新加坡和中国台湾等地区的部分岗位进行裁员，如采购、财务等，并拟在印度重新招人担任这些职务	看好印度市场增长
	德州仪器	将在美国达拉斯、日本会津和其他地方兴建 8 英寸晶圆厂，生产 GaN 半导体	GaN 半导体价格有望降低
	安森美	宣布成立模拟与混合信号事业部（AMG）	扩张汽车、工业和云端市场业务
	SK 海力士	正在重组中国业务，加大投入无锡 DRAM 工厂	看好 DRAM 增长
	三星	成立 AGI 计算实验室，开发用于 LLM 的芯片	看好 AI 芯片需求增长

（一）短期影响

● 高塔半导体拟停工，主要系订单下滑所致

由于行业不景气，高塔半导体计划将其美国纽波特海滩市的大部分业务关闭三周，在 4 月 1 日至 7 日关闭大部分业务，而在 7 月 1 日至 7 日和 10 月 7 日至 13 日关闭更多业务。高塔半

导体表示，由于客户正在清理过去两年半导体供应受限时积累的库存，该工厂的订单正在减少。

- **Arm 首次面向汽车应用发布高性能芯片设计，助力缩短智能汽车开发周期**

Arm 首次面向汽车应用发布其高性能“Neoverse”级芯片设计（这类芯片通常用于数据中心），以及一套面向汽车制造商及其供应商的新系统。该公司首次将基于 Arm 架构的技术引入汽车领域，其首款面向汽车的计算子系统（CSS）预计将于 2025 年交付，可将人工智能汽车开发周期缩短长达两年。

- **三星拟与大客户协价，提升闪存价格**

三星电子计划在 3 月至 4 月期间，与主要移动端、PC 端、服务器端客户重新协商价格，目标涨价 15%至 20%。过去一年以来，NAND 闪存市场供过于求，三星电子 NAND 闪存业务有所亏损。为减少损失，其计划与大客户进行谈判，将价格拉回到合理水平上。

（二）中期影响

- **台积电 3nm 获苹果、英特尔及 AMD 频频追单，营收占比有望突破 20%**

受益于苹果、英特尔及 AMD 三大客户频频追单，台积电 3nm 订单动能强劲，今年有望逐季增长。台积电 24 年 3nm 营收占比有望突破 20%（23 年 Q4 贡献营收占比为 15%），成为第二大营收贡献来源。

- **日月光获苹果先进封装订单，预计下半年开始生产**

日月光获苹果 M4 芯片的先进封装订单，预计在下半年开始生产。此前，苹果的 M 系列 Apple Silicon 芯片由台积电负责前道芯片生产及后道先进封装。但此次，苹果将先进封装和芯片代工订单分开，使日月光成为其先进封装产能的首个主要客户。

- **SK 海力士预计今年 HBM 芯片占公司 DRAM 芯片销售比重达两位数**

SK 海力士 CEO 表示，预计用于 AI 芯片组的 HBM 芯片在公司 DRAM 芯片销售中所占比重将从去年的个位数上升至今年的两位数。SK 海力士开始批量生产下一代先进的 HBM3E 芯片。目前三星、SK 海力士规划提高 HBM 产能最积极，其中 SK 海力士在 HBM3 市场占有率逾 90%，而三星未来将受益于 AMD MI300 芯片的逐季放量。

- **三星将推出采用 LPDDR 内存的 AI 芯片，加剧 AI 芯片市场竞争**

三星计划今年底明年初推出采用 LPDDR 内存的 AI 芯片 Mach-1。该 AI 芯片将于今年底完成制造过程，明年初推出基于其的 AI 系统。Mach-1 芯片基于非传统结构，与现有的设计相比，能显著降低推理应用的内存带宽需求，仅为原来的八分之一。此外，其无需 HBM 内存，而是选用 LPDDR 内存。

（三）长期影响

- **各大龙头厂商加大投资印度市场，布局半导体产业链**

（1）高通在印度建设设计中心：高通在印度钦奈开设新的设计中心，专门从事无线连接解决方案，助力印度进行 5G、6G 研究。该中心致力于 5G 蜂窝技术，还将推动高通在 Wi-Fi 技术方面的路线图。此外，高通还宣布一项支持印度 6G 技术的学术研究计划。

（2）瑞萨电子将在印度合资建设封测厂：瑞萨电子将与印度 CG Power and Industrial Solutions 及泰国 Stars Micro electronics 展开合作，在印度成立合资公司建设一家封测厂，总投资 760 亿卢比，日产能约 1500 万颗芯片。业务涵盖较广，从 QFN 和 QFP 等传统封装到 FC BGA 和 FC CSP 等面向汽车、消费、工业和 5G 市场的先进封装。

（3）格芯将在印度招募采购团队：格芯将在今年完成人员重组，针对新加坡和中国台湾等地区的部分岗位进行裁员，如采购、财务等，并计划在印度重新招人担任这些职务。虽然格芯尚未宣布在印度建厂，但其部分采购职能转移到印度，未来或将在印度扩张业务。

- **德州仪器转型 8 英寸生产工艺，降低 GaN 半导体价格**

德州仪器将在美国达拉斯、日本会津和其他地方兴建 8 英寸晶圆厂。其中，达拉斯工厂有望在 2025 年之前从 6 英寸工艺过渡到 8 英寸；日本会津工厂正将现有的硅基 8 英寸生产线转换为 GaN 半导体生产线。德州仪器的工艺转型有望降低 GaN 半导体价格（将生产成本降低 10% 以上），进而能够提供更低价格的器件及解决方案，获得成本竞争优势。

- **安森美成立新事业部，扩大 PMIC 和传感器接口产品组合**

安森美宣布成立模拟与混合信号事业部（AMG），专注于扩大安森美电源管理和传感器接口产品组合，加速公司在汽车、工业和云端市场的增长。

- **SK 海力士重组中国业务，加大对无锡 DRAM 工厂投入**

SK 海力士正在重组在中国的业务，计划将业务重心转移到无锡。SK 海力士在中国有三家工厂，包括无锡 DRAM 厂、大连 NAND 厂和重庆封装厂。SK 海力士已加大对无锡 DRAM 工厂的投入，投入大量资金扩大产能和提升技术水准。

- **三星电子成立 AGI 计算实验室，开发用于 LLM 的芯片**

三星电子宣布在美国和韩国成立三星半导体 AGI 计算实验室，将专注开发用于 LLM 的芯片，重点是推理和服务应用。计划是不断推出 AGI 计算实验室芯片设计的新版本，这种迭代模式将以极低的功耗和成本提供 stronger 的性能，并支持越来越大的模型。

三、终端市场动态

终端市场动态概览			
维度	厂商	经营动态	解读
人工智能	OpenAI	与微软计划投资 AI 超级计算机	AI 芯片需求将持续增长
	英特尔	宣布 AI PC 加速计划	有望推动 AI PC 渗透率提升
	阿里云	阿里大模型与联发科芯片实现深度适配	AI 手机发展加速
	联想	与英伟达合作推出全新混合 AI 解决方案	看好 AI 市场增长
	ABB	将人工智能嵌入全线业务	看好 AI 市场增长
	月之暗面	发布 Kimi 大模型	AI 芯片需求将持续增长
新能源	LG 新能源	与高通合作开发电动汽车 BMS 解决方案	看好 BMS 市场增长
	北汽蓝谷	联手宁德时代、小米汽车，拟合资建设电芯智能制造工厂	看好动力电池市场增长
	阳光电源	与美国客户签订储能产品供货协议	看好美国储能市场需求增长
	国轩高科	旗下分公司国轩日本与大和能源、CO2OS 签订合作协议，将共同在日本开展储能电站开发及运维等业务	看好日本储能市场需求增长
	天合储能	与比利时厂商签订储能供货协议	国内储能厂商出海加速
	先导智能	与美国 ABF 公司签署战略合作协议	看好美国储能市场需求增长
汽车	小米	发布 SU7 汽车	智能驾驶行业格局或将变化
	VinFast	已与泰国 15 家经销商签署合作协议，寻求在泰国市场扩张	看好泰国电动汽车需求增长
	现代汽车	计划 3 年内将在韩国投资 68 万亿韩元	看好韩国电动汽车需求增长
	福特汽车	拟为欧洲经销商提供超快速充电基础设施	加快欧洲电动化趋势
	Mobileye	将与大众汽车加强自动驾驶领域合作，共同将新的自动驾驶功能引入量产	看好智能驾驶需求增长
	小鹏汽车	新技术方案将使 XNGP 硬件成本下降 50%	高阶智能驾驶或将加速普及
	广汽埃安 昊铂	与英伟达联手量产 L4 级智能汽车	高阶智能驾驶或将加速普及
	日产汽车	计划与本田在电动汽车领域开展业务合作	看好电动汽车需求增长
	现代汽车	将以 5 纳米制程自研车用半导体	关注汽车主机厂自研芯片趋势

(一) 人工智能

● OpenAI 和微软计划投资 AI 超级计算机，带来 AI 芯片需求增长

根据 The Information，微软和 OpenAI 计划投资 1000 亿美元建造“星际之门”（Stargate）AI 超级计算机。星际之门的芯片尚未确定，参与者透露微软计划在该项目中继续使用英伟达 AI 芯片、AMD 的 GPU 芯片，或微软最近推出的自研 AI 芯片。

- **英特尔宣布 AI PC 加速计划，有望推动 AI PC 渗透率提升**

英特尔宣布“AI PC 加速计划”的两项新举措，包括推出“AI PC 开发者计划”，并吸收独立硬件供应商加入其“AI PC 加速计划”。这两项计划旨在加快于 2025 年前为超过 1 亿台基于 Intel 平台的 PC 带来 AI 特性。同时，英特尔还计划在未来一年内面向全球市场推出 12 家 OEM 厂商的 230 多款搭载酷睿 Ultra 处理器的 AI 笔记本产品，并支持 300 多项专属 AI 加速功能。

- **阿里大模型与联发科芯片实现深度适配，AI 手机发展加速**

联发科已成功在天玑 9300 等旗舰芯片上部署通义千问大模型，首次实现大模型在手机芯片端深度适配，通义千问在离线情况下运行多轮 AI 对话。阿里云表示，其将和联发科深度合作，向全球手机厂商提供端侧大模型解决方案。

- **联想与英伟达合作推出全新混合 AI 解决方案**

联想集团与 NVIDIA 宣布合作推出全新混合人工智能解决方案，帮助企业和云提供商获得在人工智能加速计算能力，将人工智能从概念变为现实。此举将推进联想集团 AI for All 的愿景，并为下一代大规模生成式人工智能的创新架构迅速进入市场提供支持。

- **工控龙头厂商 ABB 将人工智能嵌入全线业务**

ABB 将人工智能嵌入全线业务，100 多个 AI 项目正在推进中。近期，ABB 收购瑞士初创公司 Sevensense，以扩大其在新一代人工智能自主移动机器人领域的地位。此外，还收购研发工程公司 Meshmind 的大部分股份，扩大其在人工智能、工业物联网和机器视觉领域的研发能力。目前，ABB 电气、运动控制、过程自动化、机器人与离散自动化四大业务均已将人工智能投入应用，服务各行业客户。

- **初创企业发布 Kimi 大模型，预期算力需求将进一步提升**

月之暗面宣布，Kimi 智能助手已支持 200 万字超长无损上下文，并开启产品内测。Kimi 智能助手的智能搜索功能，可根据用户的问题，主动去互联网上搜索、分析和总结最相关的多个页面，生成更直接、更准确的答案。Kimi Chat 最多支持 20 万汉字的超长文本输入，是目前全球市场上能够产品化使用的大模型服务中所能支持的最长上下文输入长度。作为对比，Anthropic 的 Claude-100k 模型支持约 8 万字，而 OpenAI 的 GPT-4-32k 只支持约 2.5 万字。

(二) 新能源

- **LG 新能源与高通合作，开发电动汽车 BMS 解决方案**

LG 新能源宣布与高通合作，将为下一代电动汽车开发先进的电池管理系统（BMS）诊断解决方案。通过此次合作，LG 新能源计划将其 BMS 诊断软件与高通骁龙数字底盘的特定功能集

成，从而开发更先进的 BMS 解决方案。

● **北汽蓝谷携手宁德时代、小米汽车，拟合资建设电芯智能制造工厂**

北汽蓝谷拟与北汽产投、北京海纳川共同出资设立平台公司，并将平台公司作为管理与投资主体，与宁德时代、京能科技及小米汽车合资设立北京时代新能源科技有限公司（其中宁德时代股比为 51%），在北京投资建设电芯智能制造工厂，有利于保障北汽蓝谷动力电池的稳定供应。

● **储能厂商出海进程加速，获得海外储能大单**

(1) 阳光电源与美国客户签订供货协议：阳光电源全资孙公司 Sungrow USA 分别与 Tanzanite Energy Storage LLC、Platinum Energy Storage LLC 签订储能产品供货协议。

(2) 国轩高科拓展日本市场业务：国轩高科旗下分公司国轩日本与大和能源、CO2OS 在日本东京签订合作协议，将共同在日本开展储能电站开发及运维等业务。其中国轩日本将负责储能电池产品供应和日常运维技术支持等；大和能源将负责项目可行性评估并提供资金支持；CO2OS 将负责储能电站运维工作，并提供其他相关技术支持。预计未来 2 年内，该合作将根据电网侧储能电站及可再生能源发电侧储能电站的相关需求，引进共计 1GWh 的储能电池产品。

(3) 天合储能与比利时厂商签订储能供货协议：天合储能与比利时知名能源公司 EcoSourcen 签署战略合作协议，为其提供 100 台 10 尺定制化储能电池柜，总容量达 46.592MWh，满足全场景光储应用需求。

(4) 先导智能与美国 ABF 公司签署战略合作协议：先导智能与美国电池制造商 American Battery Factory 公司（ABF）签署全球战略合作协议，将为 ABF 公司提供总目标为 20GWh 的锂电池智慧产线服务。

(三) 汽车

● **VinFast 计划扩张泰国市场业务，看好泰国电动汽车需求增长**

越南电动汽车制造商 VinFast 宣布，已与泰国 15 家经销商签署合作协议，寻求在泰国市场扩张。泰国工业联合会数据显示 2023 年泰国纯电动汽车销量约 7.35 万辆（占泰国汽车销量约 9%），预计 2024 年，纯电动汽车销量有望增长 1 倍。

● **现代汽车加大对韩国市场投入力度，继续提升电动汽车产量**

现代汽车计划 3 年内将在韩国投资 68 万亿韩元（约合 506 亿美元），新雇佣 8 万名员工。现代汽车表示，集团的目标是到 2030 年将韩国国内电动汽车年产量扩大到 151 万辆。

- **福特汽车拟为欧洲经销商提供超快速充电基础设施，加快欧洲市场电动化趋势**

福特汽车和 Allego（领先的泛欧公共电动汽车快速和超快速充电网络公司）宣布达成战略合作伙伴关系，将为欧洲数百家福特经销商提供超快速充电基础设施。新的合作将进一步为福特电动汽车的客户提供方便可靠的充电解决方案，该公司的目标是到 2035 年在欧洲实现乘用车和商用车 100%电动化。

- **Mobileye 与大众汽车加强合作，将新的自动驾驶功能引入量产**

Mobileye 将与大众汽车加强自动驾驶领域合作，共同将新的自动驾驶功能引入量产，未来向大众旗下奥迪、宾利、兰博基尼和保时捷等品牌提供自动驾驶功能，其中包括在获允许区域和条件下在多车道高速公路上自动超车，以及在红灯前和停车标志处自动停车等。

- **小鹏汽车新技术方案将使 XNGP 硬件成本下降 50%，加速普及高阶智能驾驶**

据报道，小鹏汽车 XNGP 体验将从量变到质变，在核心区域的出行体验可对标 Waymo 在旧金山的 Robotaxi。从 24 年 H2 推出的全新车型开始，小鹏汽车计划采用的新技术方案可使 XNGP 硬件成本下降 50%，成本竞争力将大幅度提高，高阶智能化将加速普及。

- **英伟达将与广汽埃安昊铂联手量产 L4 级智能汽车，采用英伟达 DRIVE Thor 芯片**

在 NVIDIA GTC 大会上，NVIDIA 和广汽埃安昊铂宣布双方将联手量产 L4 车。昊铂下一代 L4 级自动驾驶汽车由 NVIDIA DRIVE Thor 双芯片赋能，实现行业领先的 2000TOPS 算力，将在 2025 年率先实现量产。

- **日产汽车拟与本田合作，日本汽车产业格局或从三足鼎立变两军对垒**

日产汽车计划与本田在电动汽车领域开展业务合作，考虑今后实现电动汽车核心零部件通用化、联合采购零部件及联合开发软件等，将通过削减成本加强竞争力，从而与中美等海外企业竞争。具体而言，双方将推进电动汽车核心零部件 E-Axle、电池、软件平台开发以及新车供应的相互补充等。

- **现代汽车将以 5 纳米制程自研车用半导体，有望由三星、台积电代工**

据报道，现代汽车将耗资至少达到 1000 亿韩元，以 5nm 先进制程自主研发车用半导体，从而在软件定义汽车（SDV）时代确保先进芯片供应稳定。SDV 将由软件控制汽车的有关功能，包括驾控体验、舒适性乃至安全性。预计代工厂将是三星电子或台积电。

- **小米汽车发布 SU7，智能驾驶行业格局或将变化**

小米汽车发布 SU7，提供标准版/Pro/Max 三款车型，其中标准版和 Max 版 4 月底交付，Pro 版于 5 月底交付。小米智能辅助驾驶提供两种方案：Xiaomi Pilot Pro（硬件采用 11*摄像头+12*超声波雷达+1*毫米波雷达，Orin N*1 —84Tops）实现高速 NOA 和代客泊车，以及

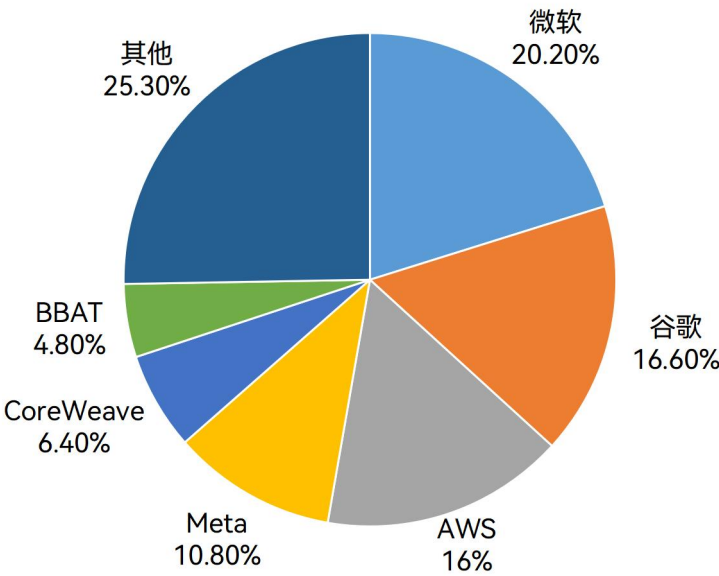
Xiaomi Pilot Max（新增 1*激光雷达以及 2*毫米波雷达，Orin*2 —508Tops）实现城市 NOA 功能。

四、重点产品行情

（一）服务器 GPU：受益于大型云端服务厂商订单拉动，AI 服务器 GPU 出货有望高增

据 TrendForce 预测，2024 年全球服务器整机出货量约 1365.4 万台，年增长率约 2.05%。其中，受益于云端服务厂商需求增长，AI 服务器出货量有望同比增长双位数，出货占整体服务器的比重约为 12.1%。

2024 年全球云端服务厂商对高端 AI 服务器需求比例预测



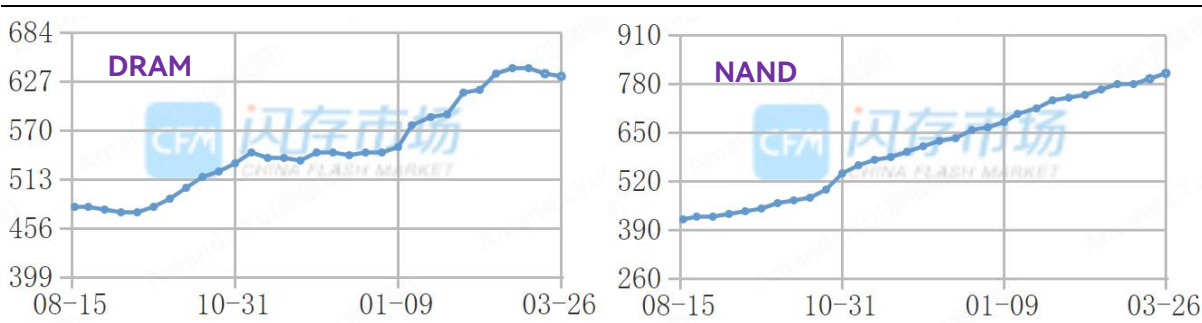
数据来源：TrendForce

就出货种类而言，2024 年，搭载高端 AI 训练芯片（如英伟达 H 系列和 AMD 的 MI 系列产品）的机种出货量有望翻倍增长，利好 AI 服务器 GPU 芯片出货增长。

（二）存储芯片：现货市场成交压力较大，Q2 预计 DRAM 环比涨幅较小

根据闪存市场数据，DRAM 价格指数较上月末有所下滑，NAND 价格指数升幅平稳。由于现货需求端普遍存在一定库存，以及终端需求未见明显好转，备货需求放缓之下，近期存储现货市场普遍面临较大的成交压力。

DRAM 及 NAND 价格指数



数据来源：闪存市场

根据 TrendForce 报告，DRAM 方面，由于今年整体需求展望不佳，加之 23 年 Q4 起供应商已大幅涨价，预计库存回补动能将逐渐走弱，24 年第二季度 DRAM 合约价环比涨幅将为 3%-8%。NAND 闪存方面，尽管 NAND Flash 第二季度采购量较第一季度小幅下滑，但受供应商库存降低，及减产效应影响，预计第二季度 NAND Flash 合约价将整体强势上涨约 13-18%。

DRAM 和 NAND Flash 合约价涨幅预测

产品	24 年 Q1 (E)	24 年 Q2 (F)
DRAM 产品		
PC DRAM	上涨 15-20%	上涨 3-8%
Server DRAM	上涨 15-20%	上涨 3-8%
Mobile DRAM	上涨 18-23%	上涨 3-8%
Graphics DRAM	上涨 13-18%	上涨 3-8%
Consumer DRAM	上涨 10-15%	上涨 3-8%
Total DRAM	上涨 20%	上涨 3-8%
NAND Flash 产品		
eMMC UFS	上涨 25-30%	上涨 10-15%
Enterprise SSD	上涨 23-28%	上涨 20-25%
Client SSD	上涨 23-28%	上涨 10-15%
3D NAND Wafers (TLC & QLC)	上涨 23-28%	上涨 5-10%
Total NAND Flash	上涨 23-28%	上涨 13-18%

数据来源：TrendForce

(三) MCU：整体库存 Q2 有望回至健康水位，部分车规类器件货期较长

根据 DIGITIMES，伴随代理及客户端库存逐渐调节结束，微控制器产业预期 2024 年第二季库存可回至健康水位，同时市场价格持续回调。

从产品行情来看，8 位 MCU、32 位 MCU 等产品货期呈现明显回落趋势，市场上通用料现货充足。部分汽车料的货期依然较长，ST 和瑞萨的汽车料货期超过 40 周。

MCU 货期及价格趋势

制造商	产品	货期趋势	价格趋势
Microchip	8 位 MCU	↘	→
	32 位 MCU	↘	→
NXP	8 位 MCU	↘	→
	32 位 MCU	↘	→
	汽车	↘	→
瑞萨	8 位 MCU	↘	→
	32 位 MCU	↘	→
	汽车	→	→
ST	8 位 MCU	↘	→
	汽车	→	→
Infineon	8 位 MCU	↘	→
	32 位 MCU	↘	→
	汽车	→	→

数据来源：富昌电子

（四）模拟芯片：Q1 末库存有望见底，Q2 交期或将延长

第一季度而言，通用模拟芯片交期缩短、价格在季度末有所下调，但后续将趋于稳定。专用类芯片则没有明显降价趋势。随着 Q1 末库存见底、需求复苏，Q2 交期或将逐步延长。

部分模拟芯片厂商价格走势

供应商	价格
瑞萨	平稳
安森美	平稳
ADI	原美信和原 ADI 旗下老型号器件价格上涨
意法半导体	平稳
Diodes	小幅下降
德州仪器	小幅下降

数据来源：四方维

五、市场重点趋势

● 小米 SU7 汽车销量超预期，关注小米汽车产业链机会

小米 SU7 汽车销量超市场预期：截至 4 月 2 日凌晨，小米 SU7 的锁单量已达到 4 万辆。为匹配销量增长，小米汽车近日要求供应商增加产能至月产 1 万辆；其中，高配版车型被要求重点增加产能。因此，电子元器件方面，可重点关注高通（骁龙 8295）、雅创电子（通过 Tier1

提供样品，自研 IC 与小米处于前期接洽）、商络电子（供应阻容感、二三极管、电源芯片等）；智能驾驶方面，可重点关注德赛西威（提供域控制器）、经纬恒润（中央域控）等。

- **华为 P70 手机即将上市，关注华为手机产业链机会**

华为 P70 系列新机预计 4 月上旬上市发布。根据天风国际证券报告，预计到 2024 年，P70 系列的销量将实现明显增长，增幅预计将达到 230%，销售量预计在 1300 万至 1500 万部之间。关注 CIS 传感器、射频芯片、模拟芯片等市场机会。

- **终端整体需求仍然疲软，关注 DRAM 价格涨幅回落情况**

由于终端市场需求增长较弱、渠道端已有一定库存，TrendForce 预计第二季度 DRAM 合约价涨幅较低，后续存储芯片价格走势仍待确认终端需求增长情况。

信息来源

- [1]美国对华芯片出口管制升级, 第一财经, 2024
- [2]韩国政府承诺继续支持芯片产业, cnBeta, 2024
- [3]印度将降低进口关税以吸引特斯拉来建厂, wsj.com, 2024
- [4]欧盟计划对从中国进口的电动汽车进行海关登记, eet-China, 2024
- [5]Arm 推出首款自动驾驶汽车芯片设计, 金融时报, 2024
- [6]NAND 或最高涨价 20%, 三星电子计划与客户重新谈判, 芯查查, 2024
- [7]台积电 3nm 获苹果、英特尔及 AMD 频频追单, 中国台湾经济日报, 2024
- [8]日月光获苹果 M4 芯片的先进封装订单, 中国台湾经济日报, 2024
- [9]今年 HBM 芯片占公司 DRAM 芯片销售比重预计达两位数, SK 海力士, 2024
- [10]三星计划今年底明年初推出采用 LPDDR 内存的 AI 芯片 Mach-1, 三星电子, 2024
- [11]高通在印度建设设计中心, DIGITIMES, 2024
- [12]瑞萨电子计划投资 760 亿卢比在印度建厂, ictimes, 2024
- [13]格芯新加坡与台湾地区裁员, 重心搬往印度, 集微网, 2024
- [14]TI 多家工厂晶圆厂转向 8 英寸 GaN 工艺 以降低生产成本, 集微网, 2024
- [15]安森美成立模拟与混合信号集团, 加速产品布局, ictimes, 2024
- [16]SK 海力士重组中国业务, 计划关闭上海公司并将重心转向无锡, 芯智讯, 2024
- [17]三星成立 AGI 计算实验室, 打造下一代 AI 芯片, 集微网, 2024
- [18]OpenAI 和微软计划投资 AI 超级计算机, the Information, 2024
- [19]英特尔宣布 AI PC 拓展新计划, 集微网, 2024
- [20]阿里云携手联发科为手机芯片适配大模型, 凤凰网, 2024
- [21]联想与英伟达合作, 推出全新混合 AI 解决方案, 凤凰网, 2024
- [22]ABB 将人工智能嵌入全线业务, ABB, 2024
- [23]Kimi 爆火, 中国大模型何时商业落地, 环球时报, 2024
- [24]LG 新能源与高通合作, 将开发电动汽车电池管理系统, 集微网, 2024
- [25]北汽携手宁德时代、小米共建电芯工厂, 北汽集团, 2024
- [26]阳光电源与美国客户签订供货协议, 阳光电源, 2024
- [27]国轩高科与大和能源合作开发储能电站业务, 国轩高科, 2024
- [28]天合储能与比利时厂商签订储能供货协议, 索比储能网, 2024
- [29]先导智能: 与 ABF 正式签约, 是中国企业迄今最大美国锂电池设备订单, 集微网, 2024
- [30]越南电动汽车制造商 VinFast 寻求在泰国市场扩张, 越通社, 2024
- [31]现代汽车加倍努力发展电动汽车, 加大在韩国的投资力度, TradingView, 2024
- [32]福特和 Allego 合作 通过超快速充电助力欧洲经销商网络实现电气化, 盖世汽车, 2024
- [33]大众汽车将与以色列自动驾驶公司 Mobileye 加强合作, 集微网, 2024
- [34]小鹏汽车发起密集产品攻势, 第一财经, 2024
- [35]埃安昊铂与英伟达共同打造 L4 量产车 计划 2025 年量产, 财联社, 2024
- [36]日产与本田将签订 EV 合作备忘录, 日本经济新闻, 2024
- [37]现代汽车计划自研 5 纳米车用芯片, ictimes, 2024
- [38]小米汽车要求供应商增加产能至月产 1 万辆, 第一财经, 2024

[39]郭明錤预测华为 P70 系列全年出货量或劲增 230%, 天风国际证券, 2024

[40]预计第二季 DRAM 价格涨幅将收敛至 3-8%, TrendForce, 2024

[41]第二季 NAND Flash 合约价将强势上涨约 13-18%, TrendForce, 2024

[42]预估 2024 年全球服务器整机出货量年增 2.05%, AI 服务器占比约 12.1%, TrendForce, 2024

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2024 年 4 月



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年。作为亚洲首选的电子元器件分销商,多年来专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们的团队始终践行着“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供极致的服务,帮助客户成功。

我们拥有150+专业资深采购团队,与全球9000+供应商深度合作,致力于用更快的速度、更低的成本,为客户解决电子元器件短缺问题。

我们在深港两地建立了业界最大的品质控制中心,以超越国际标准的品质控制体系,从供应商管控到品质检测全方位防范风险,为客户的元器件供应链安全保驾护航。



洞察行情 精准决策

